

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-152138

(43)Date of publication of application : 23.05.2003

(51)Int.Cl.

H01L 23/36

G23G 14/06

H01L 21/338

H01L 23/373

H01L 23/40

H01L 29/812

(21)Application number : 2001-343811

(71)Applicant : FURUKAWA ELECTRIC CO LTD:THE

(22)Date of filing : 08.11.2001

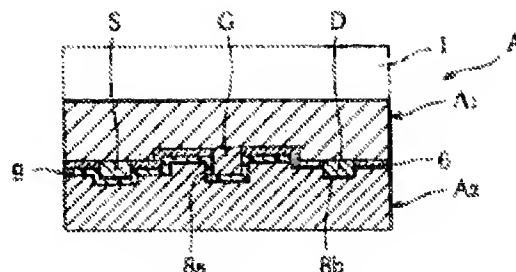
(72)Inventor : YOSHIDA KIYOTERU

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE EXCELLENT IN HEAT DISSIPATION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor device capable of driving with a large current by making use of its excellent heat dissipation.

SOLUTION: There is provided a semiconductor device excellent in heat dissipation wherein there are joined through an insulating film 9 a surface of a semiconductor device A1 including a plurality of operation electrodes S, G and D formed on the surface and a surface of a heat dissipation substrate A2 including a recessed portion 8a formed on the surface for receiving at least the operation electrodes, and a crystal growing substrate 1 upon manufacturing the semiconductor device A1 is removed.



(10) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-152138

(P2003-152138A)

(43) 公開日 平成15年5月23日 (2003.5.23)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	ページ* (参考)
H 0 1 L 23/36		C 2 3 C 14/06	A 4 K 0 2 9
C 2 3 C 14/06		H 0 1 L 23/40	F 5 F 0 3 6
H 0 1 L 21/339		23/36	C 5 F 1 0 2
23/373		29/80	B
23/40		23/36	M

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 5 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2001-343311(P2001-343311)

(22) 出願日 平成13年11月8日 (2001.11.8)

(71) 出願人 000005290

古河電気工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

(72) 発明者 吉田 清輝

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古

河電気工業株式会社内

(74) 代理人 100090022

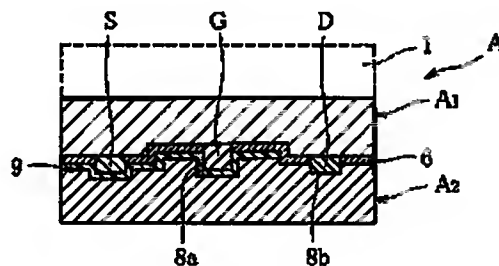
弁護士 長門 健二

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 放熱性に優れた半導体装置

(57) 【要約】

【課題】 放熱性が優れているので大電流駆動が可能な半導体装置を提供する。

【解決手段】 表面に複数個の動作電極 S、G、D が形成されている半導体デバイス A₁ のその表面と、表面に少なくとも動作電極を受容する凹部 8 a が形成されている放熱基板 A₂ のその表面とを、絶縁膜 9 を介して接合して成り、かつ、半導体デバイス A₁ 製作時の結晶成長用基板 1 が除去されている放熱性に優れた半導体装置。

(2)

特開2003-152138

1

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に複数個の動作電極が形成されている半導体デバイスの前記表面と、表面に少なくとも前記動作電極を受容する凹部が形成されている放熱基板の前記表面とを、絶縁膜を介して接合して成り、かつ、前記半導体デバイス製作時の結晶成長用基板が除去されていることを特徴とする、放熱性に優れた半導体装置。

【請求項2】 前記絶縁膜が、熱伝導性が良好な材料から成る請求項1の、放熱性に優れた半導体装置。

【請求項3】 前記材料がAlNまたはダイヤモンドである請求項2の放熱性に優れた半導体装置。

【請求項4】 前記放熱基板がCuまたはAlから成る請求項1の放熱性に優れた半導体装置。

【請求項5】 前記半導体デバイスが、GaN系半導体材料で形成されている請求項1の放熱性に優れた半導体装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は放熱性に優れた半導体装置に関し、更に詳しくは、放熱性が優れているので大電流駆動が可能であり、電界効果トランジスタ(FET)、バイポーラトランジスタ(BJT)、ヘテロ接合バイポーラトランジスタ(HBT)、サイリスタ、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)、ゲートターンオフトランジスタ(GTO)、ショットキーダイオード、p(i)n接合ダイオードなどに適用可能な構造を備えた半導体装置に関する。

【0002】

【従来の技術】GaN、InGaN、AlInGaNなどのGaN系半導体材料は、例えばGaAs系の材料に比べてそのバンドギャップエネルギーが大きく、しかも耐熱度が高く高温動作が優れており、また高周波動作も優れているので、この材料を用いて、GaN系FETの開発研究が進められている。

【0003】例えば次のようにしてGaN系のFET構造が形成されている。まず、サファイアから成る結晶成長用基板の上に、有機金属化学気相成長法(MOCVD法)やガスソース分子線エピタキシャル成長法(GSMBE法)を適用してGaNから成るバッファ層を形成する。ついで、そのバッファ層の上に、厚み2μm程度のアンドープGaN層を形成し、更にその上に、例えばSiをn型ドーパントとすることにより活性層として機能する厚み20nm程度のn-GaN層を形成してスラブ層構造にする。

【0004】ついで、このスラブ層構造の表面に、例えばプラズマCVD法により、SiO₂膜を形成したのち、ホトレジストと化学エッチングを適用してパターンニングを行い、前記アンドープGaN層の表面にソース電極用とドレイン電極用の開口箇所をそれぞれ形成し、また、前記n-GaN層の表面にゲート電極用の開口箇所

を形成する。

【0005】そして最後に、ソース電極用とドレイン電極用の開口箇所には、例えばTiやAlなどを蒸着してソース電極とドレイン電極を形成し、またゲート電極用の開口箇所には、例えばPt、Au、Pdなどを蒸着してゲート電極を形成してFET構造にする。したがって、上記したFETは、その表面にソース電極、ドレイン電極、およびゲート電極から成る3個の動作電極が突出した状態で形成されており、また全体の裏面側は各半導体層に比べて厚肉のサファイア基板で構成されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】上記したFETは電流駆動時に発熱する。とくに、大電流駆動時には、その発熱量が大きくなるため、FET温度は可成り上昇する。しかしながら、上記したFETでは、その厚みの大半は熱伝導率の低いサファイア基板で占められているため、放熱性は著しく悪い。

【0007】そのため、発熱はGaN系半導体に蓄積されてその温度を高めることになり、最悪の場合は、GaN系半導体の熱破壊を引き起こしてFET構造が機能喪失することもある。したがって、上記したFETの場合、大電流駆動を実現させるためには、不可避的に放熱性に優れた構造を形成することが必要になる。

【0008】本発明は、上記した課題を解決し、放熱性に優れた構造、すなわち大電流駆動が可能である構造になっている半導体装置の提供を目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】上記した目的を達成するために、本発明においては、表面に複数個の動作電極が形成されている半導体デバイスの前記表面と、表面に少なくとも前記動作電極を受容する凹部が形成されている放熱基板の前記表面とを、絶縁膜を介して接合して成り、かつ、前記半導体デバイス製作時の結晶成長用基板が除去されていることを特徴とする、放熱性に優れた半導体装置を提供される。

【0010】その場合、前記絶縁膜は、Alまたはダイヤモンドのような熱伝導性が良好な材料から成り、前記放熱基板はCuまたはAlから成ることを好適とする。

【0011】

【発明の実施の形態】半導体デバイスがFETである場合につき、本発明の半導体装置の1例Aを図1に示す。この半導体装置Aは、後述する半導体デバイスA₁と同じく後述する放熱基板A₂が絶縁膜9を介して接合され、そして半導体デバイスA₁の製作時に用いた結晶成長用基板1が除去された構造になっている。

【0012】半導体デバイスA₁の接合側表面には、ソース電極S、ゲート電極G、およびドレイン電極Dから成る動作電極が突出して形成されていて、同時に残りの表面は例えばSiO₂膜6で被覆されている。一方、放

(3)

特開2003-152138

3

熱基板 A_1 の接合側表面は、半導体デバイス A_2 の接合側表面とネガーボジの関係にある凹凸形状になっている。具体的には、少なくとも前記動作電極の位置に対応する表面箇所には、当該動作電極の表面視形状と相似形をなし、かつ若干大きめの凹部 $8a$ が形成されている。

【0013】そして、半導体デバイス A_2 と放熱基板 A_1 との各接合側表面のうち、少なくとも動作電極が位置している箇所には絶縁膜 9 が介在していて、動作電極の相互間における絶縁がとられている。したがって、この半導体装置 A の場合、半導体デバイス A_2 からは放熱性の悪いサファイア基板 1 が除去され、また動作電極が位置する表面には放熱基板 A_1 が接合されているので、全体としての放熱性は優れている。すなわち、発熱が大きくなる大電流駆動を行うことができる。

【0014】この半導体装置 A は次のようにして製造することができる。まず、半導体デバイスの製作について説明する。図2で示したように、結晶成長用の基板であるサファイア基板 1 の上に、例えばGa N から成るバッファ層 2 、アンドープGa N 層 3 、例えばアンドープAlGa N から成る活性層 4 、および例えばSi δ -ドープ n -Ga N から成るコンタクト層 5 を順次成膜してスラブ層構造体 A_1-1 を製作する。

【0015】ついで、このスラブ層構造体 A_1-1 の表面に、例えば熱化学堆積法でSi O_2 膜を形成し、そのSi O_2 膜にフォトリソグラフィとドライエッチングを行い、ゲート電極を形成すべき活性層 4 の表面 $4a$ を表出させたのちSi O_2 膜を全て除去し、図3で示したように中間材 A_1-2 を製作する。ついで、中間材 A_1-2 の全面に再びSi O_2 膜 6 を成膜する。そして、動作電極の形成に移る。

【0016】まず、コンタクト層 5 の上のSi O_2 膜 6 にフォトリソグラフィとブッ酸を用いたウェットエッチングを行って、ソース電極用とドレイン電極用の開口をそれぞれ形成してコンタクト層 5 の表面を表出させたのち、そこに例えばスパッタ法でAl、Ti、Auを順次堆積してコンタクト層 5 とオーミック接合する所定形状のソース電極 S とドレイン電極 D を形成する。また、例えば真空蒸着法でTa-Siなどのオーミック電極材料を堆積して電極形成を行ってもよい。

【0017】ついで、表面にリフトオフを施したのち、上記と同様にしてゲート電極を形成すべき箇所のSi O_2 膜 6 に開口を形成したのち、そこにゲート電極 G を形成する。なお、ゲート電極 G の堆積材料としては、例えばNi、Pt、Pd、Ti、Au、W、Ta、またはこれら材料を組み合わせたもの、およびSiを含むシリサイド系合金などを用いることができる。

【0018】このようにして、図4で示したように、図1で示した半導体デバイス A_2 の母材であるGa N 系FET A_1-3 が得られる。このFET A_1-3 の表面 a_1 には所定の平面視形状をしたソース電極 S 、ドレイン電極 D 、ゲート電極 G などから成る動作電極が突出形成され、全体としては凹凸形状になっている。そして背面側はサファイア基板 1 のままになっている。

【0019】次に放熱基板 A_1 の製作について説明する。まず、熱伝導率が大きく、放熱性の優れた材料から成る平板を用意する。具体的には、Cu、Al、Fe、ステンレス鋼などの金属平板や、AlN、ジルコニア、ダイヤモンドライクカーボン、またはダイヤモンドなどの板が好適である。この平板 7 の表面にフォトリソグラフィとエッチングを行って、前記した中間材 A_1-3 の表面 a_1 の凹凸形状とネガーボジの関係にある凹凸形状の表面を有する中間材 A_1-1 を製作する。

【0020】なお、このときに形成される凹凸形状は、次の工程でここに絶縁膜を形成したのち図4で示した半導体デバイス A_2 の凹凸表面 a_1 と接合させることとの関係で、当該絶縁膜を形成してもそこに半導体デバイス A_2 の凹凸表面 a_1 を受容できるように設定される。例えばゲート電極を受容する凹部 $8a$ は当該ゲート電極の平面視形状より若干大きめに形成し、また深さも若干深く形成する。

【0021】ついで、この中間材 A_1-1 の表面に例えばスパッタ法で絶縁膜の材料を被着せしめて所望厚みの絶縁膜 9 を成膜したのち、例えばリフトオフやドライエッチングを行い、必要としない箇所の絶縁膜部分を除去して、図6で示した凹凸表面 a_1 を有する中間材 A_1-2 を製作する。この中間材 A_1-2 は、ドレイン電極を受容する凹部 $8b$ には絶縁膜を形成していない事例であり、ドレイン電極は放熱基板に直接接触することになる。当該動作電極間の絶縁をとることができさえすれば、ゲート電極を受容する凹部 $8a$ 、ソース電極を受容する凹部 $8c$ のそれぞれには絶縁膜を形成しなくてもよい。

【0022】絶縁膜 9 の材料としては、電気絶縁性であることは必須要件であるが、その上で熱伝導率の大きい材料であることが好ましい。半導体デバイス A_2 の発熱に対する放熱効果を高めることができるからである。このような材料としては、例えばAlN、ダイヤモンド、Ta O_5 のような金属系酸化物、TiNのような金属系窒化物などをあげることができる。

【0023】ついで、図7で示したように、図4で示した中間材 A_1-3 の表面 a_1 と上記中間材 A_1-2 の表面 a_2 とを対向配置する。そして、例えばはんだを用いて両表面 a_1 、 a_2 を接合して中間材 A_1-3 と中間材 A_1-2 を合体し、図8で示したような中間材 A_1 とする。そして最後に、中間材 A_1 のサファイア基板 1 に対して例えばレーザ照射を行う。その結果、サファイア基板 1 が剝離除去されて、図1で示した本発明の半導体装置 A が得られる。

【0024】なお、上記した説明では、放熱基板として金属基板を用いる事例を示したが、金属基板に代えて、

(4)

特開2003-152138

5

6

例えばA1N、ダイヤモンドのように、電気絶縁性であると同時に熱伝導率が高い絶縁基板を用いることもできる。このような絶縁基板を用いれば、その表面を加工して、その表面を直接図4で示した中間材A₂-3の表面a₁と接合させることができる。すなわち、図6で示した中間材A₂-2の場合のような、表面に絶縁膜9を形成することが不要になる。

【0025】また、中間材A₂のサファイア基板1を除去する方法としては、上記したレーザ照射の外に、機械的研磨法や、化学的エッチングと組み合わせた研磨法（CMP）などを適用することもできる。

【0026】

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明の半導体装置は、放熱性の悪い結晶成長用の基板が除去されていて、しかも動作電極側には放熱基板が接合された構造になっているので、電流駆動時の発熱に対する放熱性が優れている。換言すれば、大電流駆動が可能な構造になっている。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体装置の1例Aを示す断面図である。

【図2】装置Aの製作時における中間材A₂-1を示す断面図である。

*【図3】装置Aの製作時における中間材A₂-2を示す断面図である。

【図4】装置Aの製作時における中間材A₂-3を示す断面図である。

【図5】装置Aの製作時における中間材A₂-1を示す断面図である。

【図6】装置Aの製作時における中間材A₂-2を示す断面図である。

【図7】中間材A₂-3の表面a₁と中間材A₂-2の表面a₂を対向配置した状態を示す断面図である。

【図8】中間材A₂を示す断面図である。

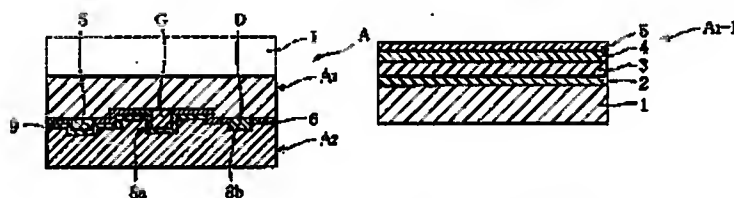
【符号の説明】

- | | |
|-------|--------------------|
| 1 | 結晶成長用基板（サファイア基板） |
| 2 | バッファ層 |
| 3 | ノンドープGaN層 |
| 4 | 活性層 |
| 4a | 活性層の表面 |
| 5 | コンタクト層 |
| 6 | SiO ₂ 膜 |
| 7 | 金属平板 |
| 8a、8b | 凹部 |
| 9 | 絶縁膜 |

*

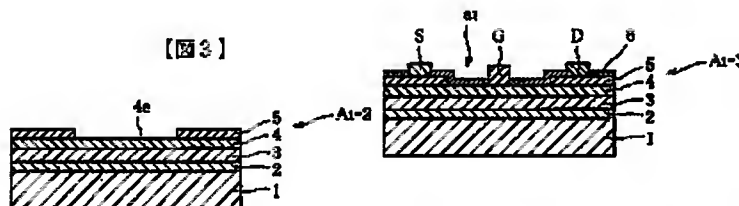
【図1】

【図2】



【図4】

【図3】



【図5】

【図6】

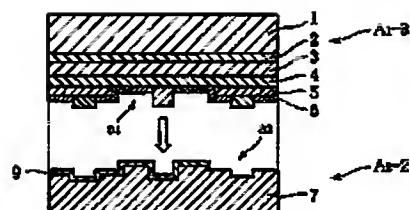


【図8】

(5)

特開2003-152138

【図7】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.

識別記号

F 1

フロント (参考)

H 0 1 L 29/812

F ターム (参考) 4K029 AA04 BA58 BC05 BD01 CA05
 5F036 AA01 BB08 BB21 BC06 BD01
 BD03
 5F102 FA00 FA02 GJ10 GK04 GL04
 GN04 GR04 GT03 GT05 GV07
 HC11 HC15 HC19